

深圳市江波龙电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-013

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	中金财富、国投证券及中小投资者代表共 23 人
时间	2024 年 9 月 6 日 (周五) 下午 14:30~16:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 许刚翎 证券事务代表 黄文芳 投资者关系资深主管 苏阳春
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司未来三到五年的战略布局规划？ 答：未来，公司将持续深耕半导体存储行业，聚焦核心竞争力建设，充分发挥综合优势，保持嵌入式存储及移动存储等基础业务的领先技术和规模优势；在此前提下，公司将不断进行产品结构的优化，加大对高毛利产品的研发和投入，如企业级、工规级等高端存储器领域，不断优

化客户结构，完善产业链布局，实现业务规模和收入的增长。

2、公司的差异化竞争优势有哪些？

答：在核心技术方面，公司在已有的技术储备及丰富的产品品类基础上，持续提升产品研发的深度与广度，长期投入研发资源，并取得积极成果。1) 在企业级产品领域，公司是国内少数具备“eSSD+RDIMM”的产品设计、组合以及持续供应能力的企业，并在互联网、运营商、金融等行业的众多客户处完成产品验证和批量应用。2) 在主控芯片领域，公司已经推出了 eMMC 和 SD 卡主控芯片（已经实现超千万颗的产品应用），并匹配自研固件算法，能够高效率满足客户的产品性能要求，增加大客户黏性；3) 公司拓展了 SLC NAND Flash 等小容量存储芯片设计能力，实质性构建了自研 SLC NAND Flash 存储芯片设计业务，产品获得客户认可，累计出货量已远超 5000 万颗。

封测制造方面，公司已在封装设计、测试算法及测试软件方面等储备了多年的实力，并于 2023 年完成了元成苏州和 Zilia 的并购，这是加强全球供应链布局，进一步开拓海外市场的重要举措，有助于公司形成全球化产能与国内产能兼顾、自主产能与委外产能并行的制造格局。

全球化布局方面，公司积极践行国内国际双循环战略，通过跨国收购 Lexar（雷克沙）品牌及巴西头部存储厂商 Zilia 的股权进一步实现了全球化布局优势，不断扩大公司的海外市场份额，为公司国际业务的中长期发展奠定坚实基础。

品牌优势方面，公司拥有行业类存储品牌 FORESEE 和国际高端消费类存储品牌 Lexar（雷克沙）。公司经过十多年的技术积累，打造了 FORESEE 品牌并在存储行业有良好的口碑；Lexar（雷克沙）是大陆地区为数不多的，拥有

全球市场影响力的消费类高端存储品牌。

3、公司在 DRAM 领域布局情况？

答：内存是公司重要产品线之一，公司内存产品涵盖了 LPDDR 及 DDR 内存条（RDIMM、SODIMM、UDIMM）等主流产品形态，广泛应用于服务器、移动终端、网络终端、电竞等多个领域。随着 AI 加速落地，公司紧抓存储行业新趋势，推出了 LPCAMM 2、CMM 2、CXL2.0 等新型内存拓展模块，为 AI 时代的大容量与高算力应用提供有力支持。

4、如何展望公司未来毛利率变化情况？

答：短期来看，受市场价格博弈影响，毛利率有所波动；长期来看，随着公司业务结构的调整，逐步向综合型半导体存储品牌公司转型，同时通过全方位布局国内、海外双循环供应链体系，公司毛利率将保持在一个相对稳健的水平。

5、公司目前的备货策略？

答：公司正加速从传统的价差模式向服务和价值模式转型，同时在库存管理上进行了全面考量，以支持长远发展。首先，公司收入规模同环比均显著提升，公司存货规模也相应增加，以更好地匹配收入规模的增长。其次，公司在多个大客户的拓展上取得突破，大客户更关注供应的一致性和长期性，公司也因此调增库存资源以满足其需求。此外，公司正在积极向高端、海外发展，中高端和新兴业务产品的库存占比不断提升，为实现公司战略目标提供了有力支持。整体来看，公司的库存结构和水平与业务增长趋势相匹配，公司的存货周转效率仍然保持在相对稳定的水平。未来，公司将进一步加强存货管理，确保库存保持在合理的水平。

6、公司是否布局 HBM 行业？

答：公司子公司元成苏州具备晶圆高堆叠封装（HBM

	<p>技术涉及的一部分) 的量产能力, 但目前无法生产 HBM。公司将保持对该技术的持续关注, 并在产品应用层面上提前开展相关的研发布局工作。</p> <p>7、下半年存储价格展望?</p> <p>答: 在经历了 2023 年年末至 2024 年第二季度前期的存储价格大幅普涨的浪潮后, 未来存储价格将再难以一概而论, 而是会根据不同的应用场景呈现结构性分化趋势。2024 年各存储原厂在供应策略上更加审慎。尽管市场显现出复苏迹象, 但各原厂在调整产能稼动率和新产能投入时, 依然采取保守态度, 以避免再次面临供过于求的风险。同时, 各原厂都在努力将产能重心转移至服务器市场的高价值产品领域。</p> <p>在需求端, 云服务提供商对 AI 硬件的持续投资, 推动了对高性能计算和存储硬件的强劲需求, 服务器领域的高速、大容量存储产品需求显著增长。除服务器外, 手机、PC 等重要下游市场需求在 2024 年逐步回暖。此外, 随着 AI 技术从云端逐步向终端设备落地, 终端设备的处理能力和数据存储需求显著提升, 单机存储容量逐渐增加, 将进一步推动了相关领域的中长期需求增长。</p> <p>在需求整体增长和供应趋紧的双重作用下, 2024 年整体来看, 半导体存储行业总体还在上行周期, 但是不同应用场景的结构性分化将会越来越明显。相较于消费类存储产品因价格上涨而不时导致上下游陷入博弈, 车规工规以及企业级服务器存储产品为主的高性能存储产品需求持续旺盛。这一新的产业趋势, 为具备高端产品及服务能力等核心竞争力的企业创造了新的增长空间和发展动力。</p>
附件清单 (如有)	无